

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2024-036

深圳市则成电子股份有限公司

关于向银行申请增加综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、综合授信基本情况概述

深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开内部总经理办公会会议，并由公司董事长薛兴韩先生签批同意了《关于公司向银行申请3,000万元综合授信额度的决定》。具体内容详见公司2023年11月9日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于新增银行综合授信额度的公告》（公告编号：2023-081）。

根据生产经营所需，公司拟向杭州银行股份有限公司深圳分行（以下简称“杭州银行深圳分行”）申请增加综合授信额度人民币2,000万元整，本次授信方式是纯信用免担保，增加授信额度后公司拟向杭州银行深圳分行申请综合授信总金额为人民币5,000万元整。

公司拟申请上述综合授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额以银行与公司发生的融资金额为准。授信额度项下具体授信品种、金额、利率、费率及期限，以单项业务合同及借款借据或其他授信凭证为准。

二、审议和表决情况

2024年6月6日，公司召开内部总经理办公会会议，并由公司董事长薛兴韩先生签批同意了《关于公司向银行申请增加2,000万元综合授信额度的决定》。根据《公司章程》的相关规定，该事项无需提交公司董事会审议。

三、对公司的影响

公司本次拟向银行申请增加综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，能够合理保证公司资金流动性和充裕性，增强资金保障能力，支持公司战略发展，对公司的日常经营产生积极的影响，将进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

《关于公司向银行申请增加 2,000 万元综合授信额度的决定》

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日